

AD Beyond Slim M830 SA

概述

频带

UHF 860 - 960 MHz

芯片

Impinj M830

芯片贴片技术

Strap Attach

天线尺寸

70 x 10 毫米

国际标准

ISO/IEC 18000-63, EPC Gen 2

行业领域

服装零售

配送中心

店铺运营

应用

品牌保护

供应链管理

日用品

RoHS

符合欧盟指令 2011/65/EC 和
(EU)2015/863

REACH

(EC) 1907/2006 号条例



通用型高性能产品

AD Beyond Slim M830 SA Inlay和标签适用于服装、零售、工业和供应链等领域，在纸板和塑料等难以标记或低失谐材料上以及其他严苛紧凑环境中都可实现优异的性能。

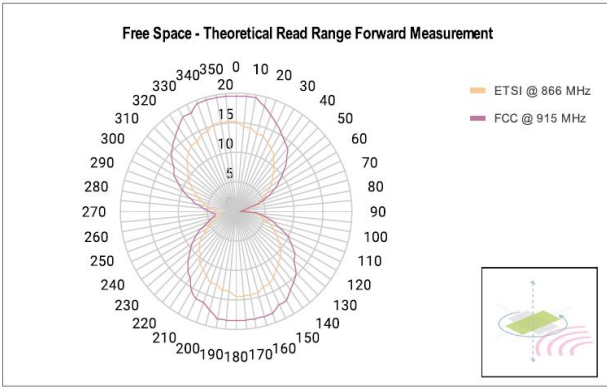
AD Beyond Slim M830 SA 天线尺寸为 70 x 10 毫米，可按照最终应用用途轻松加工。目前产品有湿 Inlay 和干 Inlay 可供选择。

AD Beyond Slim M830 SA 配备有 Impinj M830 芯片，具有 128 位 EPC 内存，兼容于全球 GS1 UHF Gen2v2 标准，满足 ISO/IEC 18000-63 标准要求。通过采用 Impinj M830 芯片，产品在灵敏度，自适应射频调谐和可靠性方面有了进一步提升，在极具挑战的环境下也能具备优异的性能表现，可助力中国客户构建效率更高，更有韧性且敏捷的供应链。

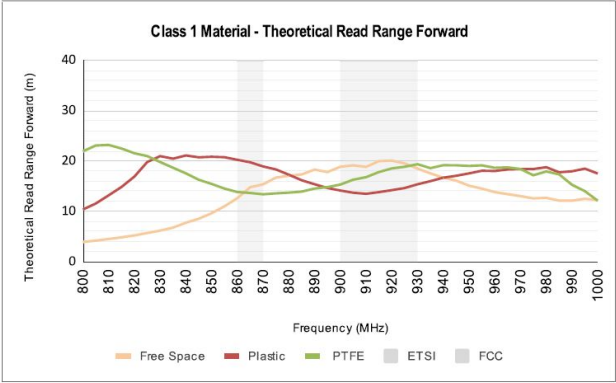
技术特性

芯片	Impinj M830		
EPC 和用户内存	128 位 / 0 位		
TID 内存	96 位 / 48 位唯一序列号		
产品代码	IL-612190	IL-612185	IL-612314
交付形式	干 inlay	湿 inlay (LTT)	湿 inlay (HM)
模切尺寸	—	73 x 19 毫米	73 x 19 毫米
Inlay 基材	40# 纸	40# 纸	40# 纸
面材	—	-	-
标准间距	19 毫米	19 毫米	19 毫米
卷宽	83 毫米	83 毫米	83 毫米
卷芯尺寸	76 毫米	76 毫米	76 毫米
数量 / 卷	TBD	TBD	TBD
工作温度	-40 °C 至 85 °C / -40 °F 至 185 °F		

方向灵敏度



读取范围



所有图表仅供参考: 在实际应用中的性能可能有所不同。

联系信息
rfid.averydennison.cn/contact



RoHS



© 2024 艾利丹尼森公司保留所有 权利。
170 Monarch Lane, Miamisburg, OH 45342, USA 本文所使用的第三方商 标和/或商品名称是其各自所有者的 财产。部分商 标仅供标识之用。
保修: 请参见艾利丹尼森 标准条款和条件: rfid.averydennison.cn/termsandconditions
保养和处理: RFID inlay 对 ESD 敏感。请遵守与电子产品/RFID 有关的行业规范, 将 对环境的影响和静 电荷降至最低。
应用: 该产品应当由客 户/用户在最终使用条件下 进行完全测试, 以确保 产品符合特定要求。艾利丹尼森未表示本 产品适于任何具体目的或用途。艾利丹 尼森保留随 时修改、更改、补充或停止 产品供应的权利, 恕不另行通知。此 处所含信息 为可靠信息, 但艾利丹尼森 对数据的准确性或精确性不作任何 陈 述。